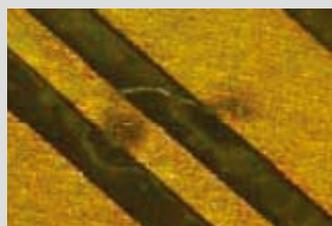


【原因、判断要点、发生工序】在覆盖层压合时卷入空气中漂浮的细微杂物所引起的。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

A fine foreign object floating in the air is entrapped during coverlay application.



【コメント】
FPC
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
FPC
显微镜倍率 ×

【Comments】
FPC
Magnification: ×



【コメント】
FPC
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
FPC
显微镜倍率 ×

【Comments】
FPC
Magnification: ×



【コメント】
FPC
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
FPC
显微镜倍率 ×

【Comments】
FPC
Magnification: ×

2-2-1-4 SR 天井裏埃附着 / SR 附着天棚里面的灰尘 / Ceiling dust on solder resist

【特徴】SR 表面に天井裏の埃が付着している状態の欠陥

【特征】SR 表面附着天棚里面的灰尘的缺陷。

【Characteristics】Ceiling dust attaches to the solder resist surface

【原因・判断ポイント・発生工程】未乾燥SRの表面に天井裏の埃が落下して付着して出来たもの（SR塗布工程）

【原因、判断要点、发生工序】从天棚里面掉下来的灰尘附着在未烘干的SR表面而引起的（涂布SR工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

Ceiling dust falls and attaches to a wet solder resist surface. (Solder resist application)



【コメント】
顕微鏡倍率 × 55

【注釋】
显微镜倍率 × 55

【Comments】
Magnification: ×55



【コメント】
顕微鏡倍率 × 16

【注釋】
显微镜倍率 × 16

【Comments】
Magnification: ×16